산업통상자원부 http://www.motie.go.kr	보 도 자 료	정부혁신 보다나은 정부

2019년 10월 25일(금) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.
(인터넷, 방송, 통신은 10. 24.(목) 오전 11시 이후 보도 가능)

배포일시	2019. 10. 24.(목)	담당부서	반도체디스플레이과
담당과장	박종원 과장(044-203-4270)	담 당 자	배은주 사무관(044-203-4274)

「제12회 반도체의 날」 기념식 개최

- '종합 반도체 강국' 도약을 위한 민·관 협력 다짐 -
- '시스템반도체 상생펀드'(팹리스지원) 출자 협약식 개최 -
- 반도체 산업 발전에 기여한 유공자 49명 포상 -

□ **산업통상자원부**(장관 성윤모)는 **'19.10.24일(목) 18시 서울 드래곤시티**에서 성윤모 산업통상자원부 장관, 진교영 한국반도체산업협회장(삼성전자 사장) 등 **반도체 분야 산·학·연 관계자 약 500여명이 참석**한 가운데 **「제12회 반도체의 날」 기념식을 개최**하였음

○ 「반도체의 날」은 우리나라 반도체 수출이 최초로 연 100억 달러를 돌파한 1994년 10월을 기념하여 제정된 이후, 2008년부터 매년 10월에 기념식을 개최해 왔으며,

○ **12회를 맞은 올해 행사**는 일본의 수출규제 강화에 따른 불확실성 증가 등에도 불구하고 다시 한 번 **반도체 한국의 위상을 높이기 위한 민·관의 긴밀한 협력을 다짐하는 자리**로 그 의미가 깊음

< 행 사 개 요 >

- **(일시/장소)** 2019. 10. 24(목) 18:00~20:00 / 서울 드래곤시티 백두홀
- **(참 석 자)** 성윤모 산업부 장관, 진교영 한국반도체산업협회장(삼성전자 사장), 산업계 대표, 반도체산업발전 유공자 등 약 500여명
- **(주요내용)** 시스템반도체 상생펀드 출자 협약식, 반도체 산업발전 유공자 포상(49점) 등

□ **성윤모 장관**은 **축사**를 통해 국가 경제를 이끌고 있는 **우리 반도체 업계의 끊임없는 노력에 감사**의 뜻을 전하며, 급박한 대외환경 대응을 위해 **민·관의 유기적인 협력이 다시 한 번 중요한 때임을 강조함**

○ 성 장관은 미-중 무역분쟁, 일본의 수출규제 강화 조치로 인한 **글로벌 공급망 불확실성 증대 등의 위기를 극복**하고, 우리의 취약한 부분을 보완하고 강화할 수 있도록 **소재·부품·장비 공급 안정화에 더욱 매진해 줄 것을 당부**하며,

○ **정부는 산업계의 노력이 성공의 결실을 맺기까지 힘찬 도움닫기가 가능**하도록, **❶소재·부품·장비 공급 안정성 확보, ❷종합 반도체 강국 도약, ❸차세대 반도체 기술경쟁력 제고, ❹포용과 상생의 산업 생태계 구축** 등 적극적인 정책적 지원을 시행할 계획임을 밝힘

○ 또한, 성 장관은, "위기를 곧 기회로 삼아 민·관이 합심하여 **우리 반도체 산업의 위상을 공고히 유지하고, '종합 반도체 강국'을 만들어 가자"고 강조**하였음

□ 아울러, 오늘 행사에서는 지난 4월 발표한 **「시스템반도체 비전과 전략」의 후속조치**로 **시스템반도체 설계전문기업(팹리스) 업계 지원을 위한 전문 펀드 조성**을 위해 반도체 대기업, 금융기관 등이 참여한 **'시스템 반도체 상생펀드' 출자 협약식도 함께 개최**함

* 양해각서 체결 : 삼성전자 정은승 사장, 에스케이하이닉스 이석희 사장, 한국성장금융투자운용 성기홍 사장, 반도체협회 설계분과 위원장 손보익 실리콘웍스 대표, 반도체산업협회장 진교영(삼성전자 사장)

○ **약 1,000억원 규모의 '시스템반도체 상생펀드'**는 **내실 있는 시스템반도체 설계전문기업에 대한 적극적인 투자 확대**를 통해 시스템반도체 산업 경쟁력 제고를 위해 마련되었으며,

○ 기존에 조성된 '반도체 성장펀드'와는 달리, **❶시스템반도체 설계기업 전용, ❷고위험(High-risk) 투자 확대, ❸중장기·대규모 투자 지원** 등의 차별성을 통해 **세계적 수준의 시스템반도체 설계전문기업 성장을 적극 지원**하고 **이에 대한 투자가 원활히 이뤄질 수 있도록 펀드를 조성**함

□ 한편, 반도체의 날을 맞아 우리 반도체 산업 발전에 각고의 노력을 기울인 **반도체 산업 유공자 49명에 대한 정부 포상**도 진행함

* 정부 포상(총49점) : 은탑산업훈장(1), 동탑산업훈장(1), 산업포장(2), 대통령표창(3), 국무총리표창(4), 산업통상자원부 장관표창(38)

○ 반도체 장비·부품 국산화 및 글로벌 시장 진출 기반을 마련하고, 국내 협력사의 동반성장 및 상생협력에 기여한 **램리서치코리아 서인학 대표이사가 은탑산업훈장을 수상**하였고,

○ **동탑산업훈장**은 **5세대 이동통신 모뎀칩의 세계 최초 상용화**를 통해 한국 반도체 산업의 위상을 드높인 **삼성전자 김민구 전무가 수상**함

○ 산업포장은 에스케이하이닉스 이기화 상무, ㈜지니틱스 박정권 대표이사, 대통령표창은 디비(DB)하이텍 이윤종 부사장, 한국과학기술원 박인철 교수, 에스케이실트론 김창열 상무, 국무총리표창은 코미코 최용하 대표이사, 오로스테크놀로지 이준우 대표이사, 세메스 김성일 상무, 케이씨텍 정의훈 부사장이 수상하였음

○ 이 외에도 산업통상자원부 장관표창 38명에 대해서도 시상하였음

< 반도체 산업발전 정부포상 대상자 >

구 분	훈 격		규모	비 고
정부 포상 (47점)	산업 훈장	은탑	1	서인학 대표이사(램리서치코리아)
		동탑	1	김민구 전무(삼성전자)
	산업포장		2	이기화 상무(에스케이하이닉스) / 박정권 대표이사(지니틱스)
	대통령표창		3	이윤종 부사장(디비하이텍) / 박인철 교수(한국과학기술원)/ 김창열 상무(SK실트론)
	국무총리표창		4	최용하 대표이사(코미코) / 이준우 대표이사(오로스테크놀로지) / 김성일 상무(세메스) / 정의훈 부사장(케이씨텍)
	장관표창		38	구창근 한미반도체 이사 외 37명

【붙 임】 1.「제12회 반도체의 날」기념식 개요
2.「제12회 반도체의 날」정부 포상자 명단

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락
이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 반도체디스플레이과 배은주 사무관(☎ 044-203-4274)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임 1 「제12회 반도체의 날」 기념식 개요

□ 추진 배경

○ 국가 주력산업인 **반도체 산업의 성과와 위상을 홍보**하고, **반도체 산·학·연의 노고를 격려**하는 「**반도체의 날**」 기념식 개최

* 반도체 수출 100억 달러 달성('94.10.29일)을 기념하여 제정, '08년 1회 행사 개최

□ 행사 개요

○ **(일시)** 2019년 10월 24일(목), 18:00 ~ 20:00

○ **(장소)** 서울 드래곤시티 백두홀(5층)

○ **(참석자)** 산업부 장관, 반도체산업협회장 및 업계 대표, 반도체산업 유공자 등 산·학·연 관계자 약 500 여명

○ **(주요내용)** 시스템반도체 상생펀드 출자 협약식, 유공자 포상 등

붙임 2 「제12회 반도체의 날」 정부 포상자 명단

□ **정부 포상** : 훈장(은탑1, 동탑1), 산업포장(2), 대통령표창(3), 국무총리표창(4), 산업부장관표창(38) 등 총 49점

포상 훈격	대상자	소속 및 직급	성명	공적 개요
산업 훈장 (은탑)		램리서치 코리아 대표이사	서인학	▪ 반도체 장비와 부품 국산화 및 글로벌 시장 진출 토대 마련 ▪ 국내 협력사 동반성장 및 상생협력에 기여 ▪ 글로벌 인재양성 프로그램 지원 및 사회공헌 사업을 통한 지역사회 발전에 기여
산업 훈장 (동탑)		삼성전자㈜ 전무	김민구	▪ 메모리 · 비메모리반도체분야 초석 마련 ▪ 국내 파운드리사업 고도화를 통한 독자생존 모델 구축(매출신장:6,666억원('15)→7,731억원('16))
산업 포장 (2점)		SK하이닉스㈜ 상무	이기화	▪ Clean Chip 적출 기술 개발 등을 통해 세계 최고 수준의 원가 경쟁력을 갖춘 TEST 기술력 확보 ▪ TEST 장비 국산화 주도 및 국내 장비 업체와의 협력 개발을 통한 대-중소기업 상생 기여
		㈜지니틱스 대표이사	박정권	▪ Touch 및 진동모터, 핀테크 IC 등의 기술 개발을 통해 국산화에 기여 ▪ 글로벌 경쟁력을 기반으로 지속적인 수출 증대에 기여
대통령 표창 (3점)		㈜DB하이텍 부사장	이윤종	▪ 국내 파운드리 사업 토대 구축을 통해 순수 파운드리 기업이 독자생존할 수 있는 비즈니스 모델 구축 ▪ 세계 최고 수준의 전력반도체 개발 등 지속적인 기술개발을 바탕으로 기술 혁신 주도
		한국과학 기술원 IDEC 소장	박인철	▪ 산업현장 수요 맞춤형 석박사 인력 및 칩 제작 경험이 있는 실무형 전문인재 양성 등을 통해 반도체설계인력 육성에 기여 ▪ 시스템반도체 분야 설계 기반 구축 지원
		㈜SK실트론 상무	김창열	▪ 시설투자 및 기술 개발을 통해 시스템 반도체용 EPI Wafer 사업 기반 확보 ▪ 국내 최고의 시스템반도체용 Wafer 공급업체로서 중국 시장 개척
국무 총리 표창 (4점)		㈜코미코 대표이사	최용하	▪ 정년폐지, 100% 정규직 채용, 유연근무제 도입 등을 통한 좋은 일터 만들기에 기여 ▪ 청년, 여성, 고졸, 장애인 등 사회적 취약계층의 채용 확대
		㈜오로스 테크놀로지 대표이사	이준우	▪ 반도체 Metrology 기술력 바탕으로 Overlay 측정 장비 제작 및 생산을 통해 국산화 기반 마련 ▪ 지속적인 기술혁신을 기반으로 대-중소 동반성장을 통한 산업기반 강화
		㈜세메스 상무	김성일	▪ Spinner 설비 개발 및 양산화 ▪ 핵심 요소기술 관련 국내 업체 육성 및 제품 적용 확대 지원
		㈜케이씨텍 부사장	정의훈	▪ Oxide CMP 공정의 ceria slurry 소재 핵심 기술 개발 및 상용화 ▪ W CMP 공정용 W Slurry 국산화 성공 및 상용화

포상훈격	소 속	직급	성명	공적 개요
산업부 장관표창 (19/30)	한미반도체㈜	이사	구창근	▪ 비전 시스템을 개발 및 적용하여 회사의 성장과 반도체 패키징 장비 국산화에 기여
	삼성전자㈜	수석	권오겸	▪ 시스템 반도체 제조를 위한 공정, analog 소자 특성 고도화를 통한 제품 경쟁력 향상
	한국산업기술대학교	교수	김기현	▪ 반도체 장비 분야 학사, 석사, 박사 인력양성 체계를 구축 및 생산효율화 기술 개발에 기여
	어플라이드머티어리얼즈코리아㈜	부장	김난영	▪ 국내 부품 협력사와의 기술 제휴 추진 및 신규 시장 개척 지원에 기여
	㈜DB하이텍	수석	김대일	▪ MCU, DRAM, LDI 등 다양한 공정 및 제품을 개발하여 국내 반도체 산업 발전에 기여
	버슘머트리얼즈 한양기공㈜	상무	김지훈	▪ 국내 가스공급시스템의 국산화 및 반도체 라인에서의 가스 안정성을 높이는데 기여
	건국대학교	교수	김진태	▪ 해외 선진 기술의 국내 이전을 통해 국내 반도체 산업 발전에 큰 이바지를 함
	앰코테크놀로지코리아㈜	수석	류창균	▪ 세라믹 flipchip BGA용 Dippable solder paste Ball attach 기술 개발에 기여
	SK하이닉스㈜	수석	문기일	▪ Memory에 최적화된 기술 개발을 주도하였으며 소재/장비/공정기술의 국산화 기여
	㈜엑시콘	수석	박상혁	▪ DRAM 메모리의 모든 제품군의 메모리 테스터를 개발하여 국산화 설비의 저변화에 공헌함
	㈜케이이씨	파트장	박재현	▪ 반도체 공정 개발/개선을 통한 신상품 개발/수율 향상으로 반도체 산업 발전에 기여
	㈜실리콘마이터스	수석	박창섭	▪ IFPM IC 개발에 성공함으로 수입대체 효과 및 동 산업계의 국가경쟁력 상승에 기여
	한국전자통신연구원	책임	박형일	▪ 인체 통신 기반 터치 케어 및 캡슐 내시경 사업화 추진으로 인체통신 원천기술의 개발 기여
	피에스케이㈜	수석	배경호	▪ 반도체의 핵심 제어 소프트웨어의 개발 및 고도화와 반도체 제조공정 적용에 기여
	중앙대학교	교수	백광현	▪ 팹리스 기업과 공동 연구과제 수행을 통한 기업 경쟁력 향상 및 인력양성에 기여
	㈜메카로	이사	석동수	▪ 반도체 DRAM 커패시터 high-k용 ALD 전구체의 양산화 및 자동화 제조라인 구축에 기여
	㈜원익아이피에스	부장	송민기	▪ 외산 일색인 반도체 설비 시장에서 자체 소프트웨어 플랫폼과 Architecture 개발의 기여
	㈜동진쎄미켐	차장	신성건	▪ 반도체 공정용 Wet chemical 소재 개발 및 외산 소재를 국산화 하는데 기여
	㈜에스티아이	이사	윤병춘	▪ 한국 CCSS장비의 기술력 극대화 및 반도체 장비 수출 증대에 크게 기여

포상훈격	소 속	직급	성명	공적 개요
산업부 장관표창 (11/30)	㈜엘오티베큠	상무	이상길	▪ 건식진공펌프의 개발을 통해 제품 국산화와 기술 자립화 달성 및 시장 확대에 기여
	SK하이닉스㈜	수석	이성훈	▪ 장비 개발 프로젝트 수행 등을 통해 국내 반도체 산업의 인프라 강화에 기여
	㈜테크원	대표이사	이천재	▪ PCI Motion 제어 Controller의 개발 공급으로 공장 자동화 설비의 국산화에 기여
	경희대학교	교수	장익준	▪ 반도체 설계 관련 우수한 연구 성과를 창출하였고, 다수의 석박사 인력 양성에 기여
	㈜넥스틴	수석	장한오	▪ 광학 검사 장비를 최초로 국산화 성공 및 수출을 통한 국내 반도체 산업 발전에 기여
	성균관대학교	교수	전정훈	▪ 반도체시스템공학 관련 교육 프로그램의 개발 및 운영 등을 통해 고급 인력 양성에 기여
	㈜가온칩스	대표이사	정규동	▪ 시스템 반도체 산업의 토탈 시스템 솔루션 구축 등 국내 시스템반도체 산업발전에 기여
	㈜실리콘웍스	담당	정종휘	▪ 국내 시스템반도체 분야 초석을 마련 및 기술경쟁력 제고 및 기술보급/확산에 기여
	㈜넥스트칩	상무	정회인	▪ 국내 Fabless 산업 발전을 위한 시스템 반도체 활성화 방안 도출 및 반도체 산업 발전에 기여
	㈜유진테크	상무	현준진	▪ 장비 분야 세계 최초, 최고 핵심 원천 기술 개발로 반도체 산업 발전에 기여
	삼성전자㈜	수석	황 찬	▪ 패터닝 공정의 핵심 기술을 개발하여 제품 개발 선도, 메모리 시장 점유율 및 수출 확대에 기여
산업부 장관표창 (동반성장) (8/8)	㈜원익아이피에스	부장	김종환	▪ 반도체 메모리 Device의 개발 및 제조 기술 경쟁력 강화 활동을 통해 반도체 산업 발전에 기여
	SK하이닉스㈜	수석	김태환	▪ Batch ALD Nitride 장비의 국산화 및 양산화를 통해 국내업체의 기술력 향상에 기여
	㈜DB하이텍	수석	서승수	▪ 국내 최초로 TEL Furnace WAVES 설비 개조에 성공하였으며, 기술 역량 강화에 기여
	㈜테스	부사장	안병대	▪ 반도체 전공정 핵심장비인 Hardmask 증착용 PECVD ACL 장비의 개발을 주도
	와이아이케이㈜	수석	이건호	▪ 반도체 검사 장비의 국산화 부품 채용에 따른 수입 대체 및 내수 활성화에 기여
	주성엔지니어링㈜	책임	조일형	▪ 반도체 장비 내 주요 가공 및 제어 구성품 등에 대한 부품 국산화율 증대에 기여
	피에스케이㈜	책임	최민호	▪ 반도체장비 소프트웨어 성능 향상 및 고객사의 VOC에 적극 대응하여 매출/수출 증대에 기여
	삼성전자㈜	수석	최삼종	▪ 반도체용 핵심 소재 기술 국산화 및 내재화에 기여하였으며, 상생 협력 추진에 기여